



TE传感器解决方案

数字元件传感器

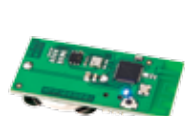


数字元件传感器和开发工具

TE的数字输出传感器中的众多产品都支持低功耗、小尺寸的形式，适用于穿戴式以及微型设备，以收集和共享健康状况、能量消耗、空气质量、空间、电池功率以及相关应用。为促进信息共享并减少投入市场的时间，我们与半导体制造商合作开发了这些针对Xplained Pro Sensor Hub, MicroChip PicTail的即插即用工具，及基于Digilent Pmod™的开发平台。另外，我们还提供多种无线传输模块和开发板，及对应的软件/固件驱动、文件和图形用户接口，帮助工程师快速完成无线应用设计目标。



无线传感器模块和开发工具



MEAS 环境传感器标识

类型	湿度，温度，压力
参数	<ul style="list-style-type: none"> • 0~100% RH • 20°C ~ 85°C • 300~1,200 mbar
通讯	标准2.4 GHz无线通讯
应用	iOS 7.0+ Android™ 4.3+



MEAS无线 M5600系列

类型	压力
参数	<ul style="list-style-type: none"> • 50~15K psi • 类型 G/S/C
通讯	标准2.4 GHz无线通讯
应用	iOS 7.0+ Android™ 4.3+



MEAS无线 U5600系列

类型	压力
参数	<ul style="list-style-type: none"> • 2~10K psi • 类型 G/S/C/A
通讯	标准2.4 GHz无线通讯
应用	iOS 7.0+ Android™ 4.3+



MEAS无线 FX1951

类型	力
参数	<ul style="list-style-type: none"> • 0~50 lbf
通讯	标准2.4 GHz无线通讯
应用	iOS 7.0+ Android™ 4.3+

PICTAIL PLUS



MEAS HTU21D(F), MS5637, MS8607, TSY501*

类型	湿度，温度，压力
参数	<ul style="list-style-type: none"> • 0~100% RH • -20°C ~ 85°C • 300~1,200 mbar
TE 模板	PicTail Plus
第三方模板	Microchip Explorer 16

*温度系统传感器(TSYS)系列

外围模块

Digilent Pmod™



MEAS HTU21D(F)

类型 湿度
参数 • 0~100% RH
• -40°C ~ 125°C
• 3.3~5.5 V
精度 ±3% RH
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™



MEAS MS5637

类型 压力
参数 • 10~2,000 mbar
• -40°C ~ 85°C
• 1.5~3.6 V
精度 ±2 mbar
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™



MEAS MS8607

类型 压力, 温度, 湿度
参数 • 10~2,000 mbar
• -40°C ~ 85°C
• 0~100% RH
• 1.5~3.6 V
精度 ±3% RH, ±2 mbar, ±1.0°C
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™



MEAS TSYS01*

类型 温度
参数 • -40°C ~ 125°C
• 2.2~3.6 V
精度 ±0.1°C
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™



MEAS TSYS02D*

类型 温度
参数 • -40°C ~ 125°C
• 1.5~3.6 V
精度 ±0.2°C
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™



MEAS KMA36(A)

类型 角度, 位置
参数 • 0~360°
• -25°C ~ 85°C
• 2.9~6.0 V
精度 ±0.1°
通用协议 I²C
板载接口 6 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 开发系统兼容连接 Digilent Pmod™

插接板



MEAS HTU21D(F)

类型 湿度
参数 • 0~100% RH
• -40°C ~ 125°C
• 3.3~5.5 V
精度 ±3% RH
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作



MEAS MS5637

类型 压力
参数 • 10~2,000 mbar
• -40°C ~ 85°C
• 1.5~3.6 V
精度 ±2 mbar
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作



MEAS MS8607

类型 压力, 温度, 湿度
参数 • 10~2,000 mbar
• -40°C ~ 85°C
• 0~100% RH
• 1.5~3.6 V
精度 ±3% RH, ±2 mBar, ±1.0°C
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作



MEAS TSYS01*

类型 温度
参数 • -40°C ~ 125°C
• 2.2~3.6 V
精度 ±0.1°C
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作



MEAS TSYS02D*

类型 温度
参数 • -40°C ~ 125°C
• 1.5~3.6 V
精度 ±0.2°C
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作



MEAS KMA36(A)

类型 角度, 位置
参数 • 0~360°
• -25°C ~ 85°C
• 2.9~6.0 V
精度 ±0.1°
通用协议 I²C
板载接口 10 x 2 x 0.1" 接头输入输出
兼容 结合Xplained Pro 开发平台配置操作

驱动



MEAS HTU21D(F)

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux® / Android™
语言 ANSI C Coding



MEAS MS5637

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux® / Android™
语言 ANSI C Coding



MEAS MS8607

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux® / Android™
语言 ANSI C Coding



MEAS TSYS01*

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux® / Android™
语言 ANSI C Coding



MEAS TSYS02D*

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux / Android™
语言 ANSI C Coding



MEAS KMA36(A)

类型 SAMD2xMicrochip PIC24x Family FPGABareMetal-Linux® / Android™
语言 ANSI C Coding

*温度系统传感器(TSYS)系列

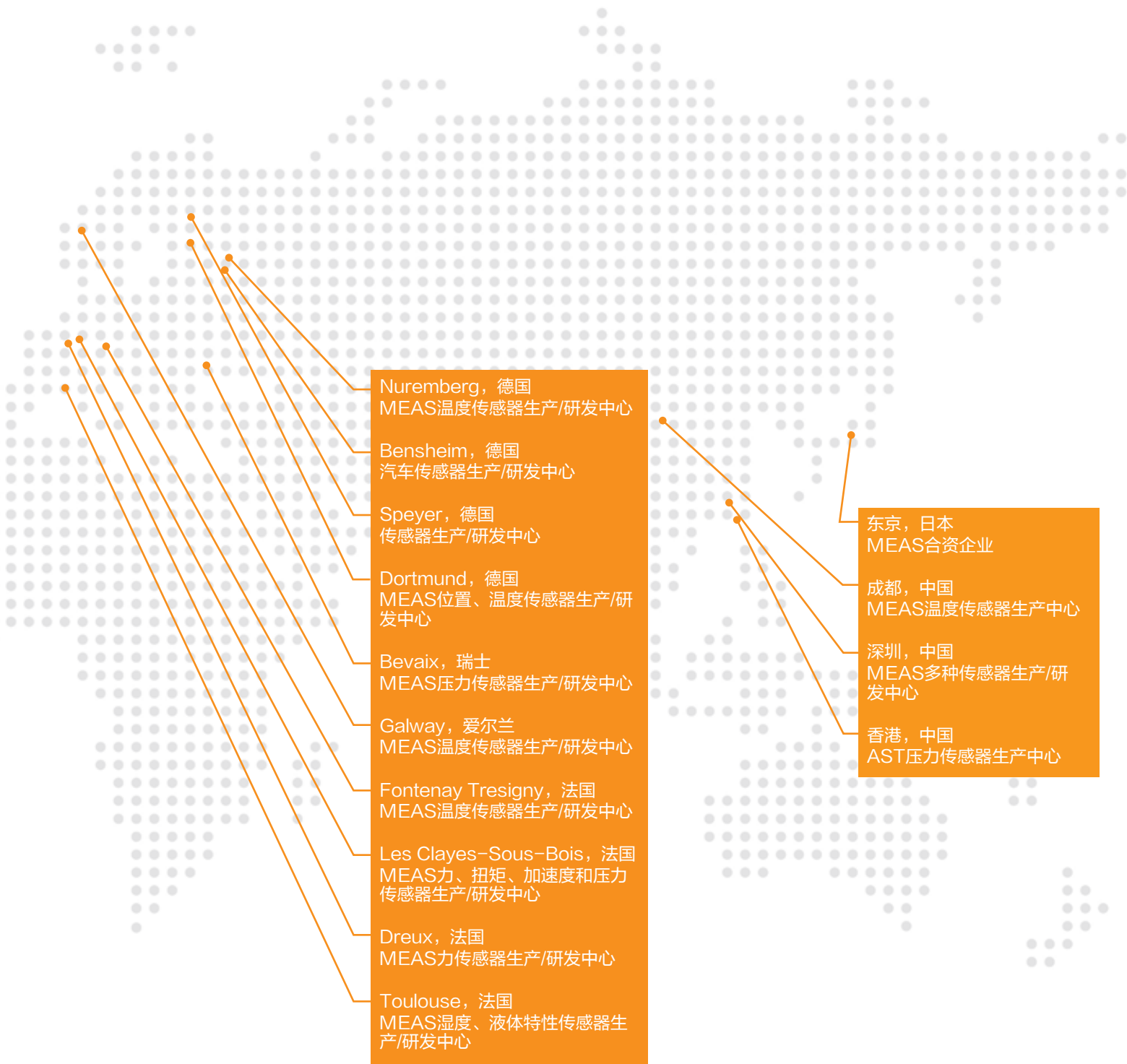
EVERY CONNECTION COUNTS

TE Connectivity是全球技术领先的连接器和传感器设计与制造商，提供的连接和传感解决方案为当今日益紧密连接的世界来说至关重要。

我们的连接和传感方案无处不在!



TE设计、制造和运输的产品、系统和解决方案服务于150多个国家和地区。遍布全球的服务让我们能够与客户紧密合作，及时发现并响应当地需求，为其提供优质、高效和创新的服务。



Nuremberg, 德国
MEAS温度传感器生产/研发中心

Bensheim, 德国
汽车传感器生产/研发中心

Speyer, 德国
传感器生产/研发中心

Dortmund, 德国
MEAS位置、温度传感器生产/研发中心

Bevaix, 瑞士
MEAS压力传感器生产/研发中心

Galway, 爱尔兰
MEAS温度传感器生产/研发中心

Fontenay Tresigny, 法国
MEAS温度传感器生产/研发中心

Les Clayes-Sous-Bois, 法国
MEAS力、扭矩、加速度和压力传感器生产/研发中心

Dreux, 法国
MEAS力传感器生产/研发中心

Toulouse, 法国
MEAS湿度、液体特性传感器生产/研发中心

东京, 日本
MEAS合资企业

成都, 中国
MEAS温度传感器生产中心

深圳, 中国
MEAS多种传感器生产/研发中心

香港, 中国
AST压力传感器生产中心

校正

测试确认传感器的输出对特定的输入值在规定的范围内

补偿温度范围

传感器的热零点漂移和热灵敏度漂移满足参数要求的温度范围

DeviceNet™

用于工业自动化的设备层网络

激励

激励标准传感器的推荐电压

满量程输出 (FSO)

传感器输出的最小值和最大值之间的范围

迟滞

传感器在常温下正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值 Δ MAX与满量程输出的百分比表示

固有频率

传感器元件对特定输入产生谐振并以最大位移作为回应的频率

非线性误差

在规定条件下,传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差(Δ Ymax)与满量程输出(Y)的百分比

非重复性

传感器在相同条件下多次测试所得特性曲线的不一致程度

工作温度

传感器正常工作温度范围,超出该范围时将导致传感器不能正常工作

过载极限

传感器不会受到损坏的最大输入

即插即用

采用供电和信号线连接到仪器后即可满足终端用户所需校正性能标准的传感器设计

实际有效值

RMS值实际就是有效值,就是一组统计数据的平方的平均值的平方根。

密封

传感器采用封装方法进行防潮。最理想的方法为气密封,通常采用焊接、钎焊、玻璃或其它可接受的制造过程将独立部分连接到一起。另外一种普通密封方法为环氧封装,通过胶粘剂或灌封化合物连接各部分,以减少水分侵入传感器

灵敏度

每单位物理参数变化所引起的传感器输出线性或非线性变化

热灵敏度漂移 (TSS)

由于温度的变化而引起的灵敏度漂移

热零点漂移 (TZS)

由于温度变化而引起的零点漂移

总误差带 (TEB)

TEB结合了传感器在测量量程和工作温度范围内所有可能出现的误差,一般用百分数表示

ABS: 防抱死刹车系统	IEEE: 电气和电子工程师协会	PSI: 磅 / 平方英寸
AC: 交流	IEPE: 压电集成电路	PTFE: 聚四氟乙烯
ANSI: 美国国家标准协会	IP: 电荷输出型	PUDF: 公开使用数据文件
ASIC: 应用型专用集成电路	ISO: 国际标准化组织	PWM: 脉冲宽度调制
ATEX: 欧洲防爆认证	ITAR: 国际武器贸易条例	R&D: 研究与开发
BOP: 防喷器	kHz: 千赫兹	RDT&E: 研究, 研发, 测试与评估
CAN: 控制器局域网	LED: 发光二极管	RFI: 射频干扰
CE: 欧盟安全认证	LIN: 局域互连网络	RH: 相对湿度
CENELEC: 欧洲电工委员会认证	LVD: 低电平指令	RMS: 均方根
CSA: 加拿大标准协会认证	LVDT: 线性可变差动变压器	RoHS: 有害物质禁用指令
CT: 计算机X光断层扫描仪	mA: 毫安	RPM: 每分钟转动次数
CUL: 加拿大安全认证	MAF: 空气流量计	RTD: 热电阻
DC: 直流	mbar: 毫巴	RTU: 远程终端
DCS: 分布式控制系统	MCR: 主控室	RVDT: 角度可变差动变压器
DTC: 数字温度补偿	MEMS: 微机电系统	SAE: 自动化工程协会
ECU: 发动机控制器	mHz: 兆赫兹	SCADA: 数据采集与监控系统
DEF: 柴油机废气处理液	mm: 毫米	SCR: 选择性催化还原
EGR: 废气再循环	MQS: 军用质量标准	SDI-12: 串行数据接口为1200波特
EMC: 电磁兼容	MR: 磁阻	SMD: 表面贴装元件
EMI: 电磁干扰	mV: 毫伏	SPDT: 单刀双掷开关
ESA: 欧洲太空总署	NAV: 导航	SpO ₂ : 血氧浓度
FLS: 现场可加载软件	NASA: 美国国家航空和宇宙航行局	SPDT: 单刀双掷开关
FM: 美国工厂互检业务协会认证	NEMA: 美国电气制造商协会	SPI: 串行外设接口
FPGA: 现场可编程门阵列	NIST: 国家标准技术局	SPST: 单刀单掷开关
FS: 满量程	NOx: 氮氧化物	T&M: 测试测量
FSO: 满量程输出	NPT: 美国标准管螺纹	TDFN: 扁平无引脚封装方式
FT LBS: 英尺磅	NSF: 国家科学基金会	TPMS: 轮胎压力监控系统
GPS: 全球定位系统	NTC: 负温度系数	TSYS: 温度系统传感器
HUMS: 健康和使用的监测系统	OEM: 设备制造厂商	TEB: 总误差带
HVACR: 暖通空调及制冷	PCB: 印刷电路板	TE: TE Connectivity
HVD: 高电平指令	PDF: 可移植文件格式	TESS: TE 传感器解决方案
HZ: 赫兹	PDM: 脉冲调制	UL: 美国安全认证
I ² C: 内部集成电路	PE: 压电	USB: 通用串行总线
IEC: 国际电工委员会	PLCD: 永磁直线位移传感器	VDC: 直流电压
IECEX: 国际电工委员会防爆电气产品认证体系	PPS: 聚苯硫醚	WEEE: 电子设备废弃物处理法

© 2016 TE Connectivity 所有下属关联公司。版权所有

Android 是 Google Inc. 公司的商标。

CANopen® 是 CAN in Automation 的注册商标。

DeviceNet™ 是 ODVA, Inc. 公司的商标。

IOS 是 Cisco 公司在美国和其它国家的商标或注册商标, 并被许可使用。

Linux® 是 Linus Torvalds 公司在美国和其它国家的注册商标。

Noryl® 是 Sabic Innovative Plastics IP BV 公司的注册商标。

Pmod 是 Diligent Inc. 公司的商标, 并被许可使用。

Accustar, ATEXIS, DEUTSCH TruBlue, KPSI, Microfused, UltraStable, IdentiCal, Krystal Bond, Measurement Specialties, measurement SPECIALTIES (标识), MEAS, American Sensor Technologies, AST, TE Connectivity, TE connectivity (标识), 和 TE (标识) 是 TE Connectivity 所有下属关联公司的商标。

其它标识、产品和公司名称可能是各自所有人拥有的商标。

TE 已尽全力确保本文的准确性, 但 TE 并不保证本文不会出现任何纰漏, 对信息的准确性、正确性、可靠性及现行有效性, TE 亦不做任何其它说明或担保。TE 保留在不作任何通知的情况下, 对此处所含信息随时进行修改的权利, 并明确否认曾作出与此处信息相关的任何暗示性的保证, 包括但不限于对适用性或对于某个特定用途的适用性的任何暗示性保证。本文中的尺寸数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。规格如有更改, 恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 TE。



SMARTER SOLUTIONS START WITH TE SENSORS

www.sensorway.cn

© 2017 TE Connectivity. 版权所有。

SS-TS-TE100 06/2017

TE传感器解决方案

北京赛斯维测控技术有限公司
北京市朝阳区望京西路甲50号
卷石天地大厦B座1001

电话：+86 010 8477 5646

传真：+86 010 5894 9029

Email: sales@sensorway.cn